

VMV Dimensioning System

3D 스냅샷 기술로 다양한 물체 측량

SICK
Sensor Intelligence.

VMV Dimensioning System



제원 개요

산업 분야	유통 및 풀필먼트 소화물, 우편 및 화물 창고 자동화
이송 속도	≤ 0 m/s ... 2 m/s (시작/정지 모드 가능) (모델에 따라 다름)
물체 식별 정확도	± 5mm x ± 5mm x ± 2mm ~ ± 10mm x ± 10mm x ± 5mm
최소 물체 크기	40 mm x 40 mm x 10 mm ... 100 mm x 100 mm x 50 mm
물체 최대 크기	700 mm x 500 mm x 400 mm ... 1200 mm x 1000 mm x 800 mm
출력 데이터	Minimum Bounding Box의 최대 치수(길이, 폭, 높이), 부피(Minimum Bounding Box), .png로 이미지 출력

제품 설명

추적 시스템인 VMV Dimensioning System이 물체의 정확한 길이, 너비, 높이를 측정합니다. 정적 프로세스 및 동적 프로세스 각자에 적합한 시스템 이형이 있습니다. 3D 스냅샷 기술은 측정 프로세스 내에서 3D 포인트 클라우드를 생성합니다. 이는 물체의 치수, 모서리 좌표 및 회전 각도를 정확하게 파악하는 데 사용됩니다. 3D 카메라는 RGB 이미지도 캡처하는데, 이 이미지는 결과를 최적화하고 문서화하는 데 사용됩니다. 반투명 표면과 같이 특히 까다로운 물체를 위한 추가 AI 기반 소프트웨어 모듈을 사용할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK

- 3D 포인트 클라우드 생성을 위한 3D 스냅샷 기술
- AI 지원 소프트웨어 모듈
- 설치 도우미
- RGB 이미지 캡처

이점

- 가변 컨베이어 속도를 통한 빠른 치수 측정
- 까다로운 물체 치수 측정: 광택, 검은색 또는 반투명 표면, 매우 평평한 물체 및 컨테이너 안의 물체
- 신속하고 간단한 설치
- 위치 및 회전 위치를 기록하여 데이터를 다운스트림 프로세스 단계(예: 분류 로봇)로 전송하는 프로세스 자동화

적용 영역

- 정적 및 동적 프로세스에서 물체 치수 측정
- 다운스트림 프로세스 테스트: 분류, 컨테이너 내 물체 분류, 배송 라벨 위치 지정
- 충전 레벨 및 오버플로 제어를 위한 컨테이너 내 물체 측정
- 적합한 컨베이어 보조 장치 결정
- 실제 제품 치수를 ERP 시스템의 데이터와 비교하여 물체 검증

주문 정보

기타 장치 버전 및 액세서리 ➜ www.sick.com/VMV_Dimensioning_System

한눈에 보는 SICK

SICK는 산업용 지능형 센서 및 센서 솔루션 분야를 선도하는 제조사입니다. 독보적 제품 및 서비스 스펙트럼을 바탕으로 안전하고 효율적인 프로세스 제어, 인명 사고 예방, 환경 파괴 방지를 위한 완벽한 기초를 마련합니다.

SICK는 다양한 업종에서 쌓은 폭넓은 경험을 보유하고 있으며 업종마다 고유한 프로세스와 요구사항을 잘 알고 있습니다. 그래서 SICK는 정확히 고객의 요구사항에 맞춘 지능형 센서 솔루션을 제공할 수 있습니다. 유럽, 아시아, 북아메리카의 어플리케이션 센터에서는 시스템 솔루션을 고객 맞춤형으로 시험하고 최적화합니다. 이 모든 것이 SICK를 신뢰할 수 있는 공급업체와 개발 파트너로 만듭니다.

SICK의 제품을 완성하는 것은 포괄적인 서비스입니다. SICK LifeTime Services는 기계가 수명을 다할 때까지 전 기간 동안 안전과 생산성을 책임집니다.

이것이 **SICK**에서 말하는 "센서 인텔리전스"입니다.

전 세계 어디서든 고객 곁에 있는 SICK.

담당자 연락처 및 다른 소재지 ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.